

# SMコンタクト

SM contact

SM-E241512-PB



- 材 質 /Material ..... リン青銅 (t=0.08mm) Phosphor bronze (t = 0.08 mm)
- メッキ処理 /Plating ..... 全面: Niメッキ      Whole surface: Ni plating  
半田付部: Snメッキ      Soldered area: Sn plating
- 推奨使用範囲 /Recommended operating range ..... 高さ = 0.7 ~ 1.4mm      Height: 0.7mm to 1.4mm

## 用途

## Applications

- パソコン、プリンター、FAX、複写機、AV機器、家電製品、測定器等の電子機器装置全般。

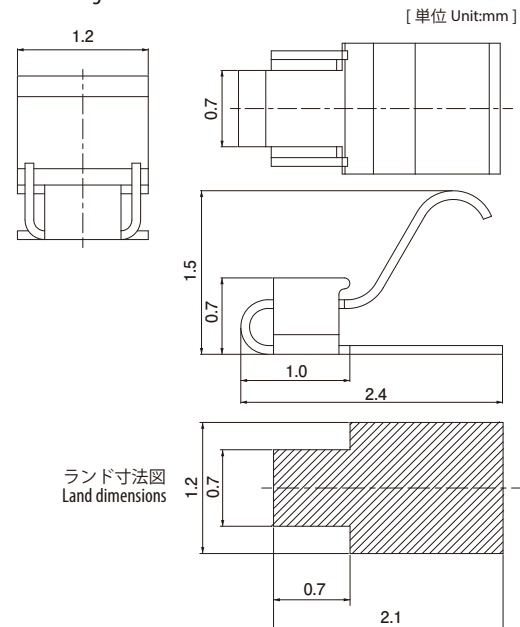
General electronic equipment, including computers, printers, facsimiles, copy machines, AV equipment, household appliances, and measuring instruments.

## 標準梱包数量

## Standard packaging quantity

梱包形態 Packaging	数量 Quantity	備考 Remarks
テーピング Taping	10,000ヶ(リール) 10,000/reel	
ダンボール Corrugated cardboard	150,000ヶ(外箱) 150,000/box	15リール / 1箱 梱包 Fifteen reels are packed in each box.

\* 外箱の数量はご注文数、箱のサイズにより変更する場合があります。  
\* The quantity in a box may vary depending on the quantity ordered and/or box size.



## 特性

## Physical properties

試験項目 Test item	性能・規格 Performance/specifications	試験方法及び条件
初期抵抗値 Initial resistance	0.1Ω以下 0.1Ω or less	測定用基盤に半田付けし、製品を1.0mmに圧縮した時の抵抗値を測定する。
圧縮荷重 Compressive load	0.5N以下 0.5N or less	測定用基盤に半田付けし、製品を1.0mmに圧縮した時の反発力を測定する。
高温試験 High temperature test	0.1Ω以下 0.1Ω or less	製品を1.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。 処理温度: 85°C 処理時間: 500hr
耐湿試験 Humidity test	0.1Ω以下 0.1Ω or less	製品を1.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。 処理温度: 65°C/95% RH 処理時間: 500hr
低温試験 Low temperature test	0.1Ω以下 0.1Ω or less	製品を1.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。 処理温度: -40°C 処理時間: 500hr
ヒートサイクル試験 Temperature cycle test	0.1Ω以下 0.1Ω or less	製品を1.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。 処理温度: -40°C(1hr)~85°C(1hr) 処理時間: 100サイクル
圧縮永久歪率測定 Compression set measurement	30%以下 30% or less	製品を1.0mmに圧縮した状態で処理を行い、処理後に抵抗値の測定を行なう。 処理温度: -40°C(3hr)~85°C(3hr) 処理時間: 12サイクル 歪率(%) = (t0-t1)/(t0-t2) x 100    t0: 初期高さ    t1: 処理後高さ    t2: スペーサー
半田濡れ性試験 Solder wettability test	浸漬部分95%以上 At least 95% of the immersed area is wet with solder.	半田槽に製品を浸けて製品の浸漬部分を確認する。半田: PF305    フラックス: ロジン(JIS K 5902)のIPA(JIS K 8839)溶液とし、その濃度は重量比約25%とする。半田温度: 245±3°C    浸漬時間: 5sec